

当社受託加工実施例（試作・開発を含む）

対象分野	処理目的	処理薄膜	基板種類
電気・電子部品	導電膜、電極	Au、Al、Cu、Cr、 Ni Au/Ni/Cu/Cr Au/Pt/Ti 他	セラミックス 圧電セラミックス ガラス基板 ポリイミド
	超電導膜	Nb、Au/Nb	金属+セラミックス
	絶縁保護膜	Al ₂ O ₃ 、AlN SiO ₂ 、Si ₃ N ₄	金属+樹脂 セラミックス+樹脂 シリコンウェハー サファイアウェハー ICパッケージ リードフレーム その他
ディスプレイ	導電膜、 透明導電膜	ITO、In ₂ O ₃ 、 Al、Cr、Pt/Ti	ガラス基板 樹脂基板
	絶縁保護膜	MgO、SiO ₂ 、Si ₃ N ₄	
メカトロニクス部品 金型	耐摩耗 離型性 防食	Al ₂ O ₃ 、SiO ₂ 、ZrO ₂ TiN、TiC、CrN、 BN、Mo	硝子レンズ金型 樹脂金型 VTRドラム 磁気ヘッド キャプスタン軸 その他
超高真空装置 成膜装置 半導体製造装置	表面硬化	TiC	フランジ
	汚染防止 耐蝕	Al ₂ O ₃ 、AlN、 SiO ₂ 、Si、SiC	ウェハーキャリア サセプター 静電チャック スパッターリング ターゲット
	電気絶縁性	SiO ₂ 、Si ₃ N ₄	ボールねじ その他
	接合 ボンディング	Cr、Cu/Cr、 In/Cu	
	固体潤滑	Au、Ag、Pt、BN	
航空・宇宙関連	防食、軽量化	Al、Au、Pt、 Al ₂ O ₃ 、SiO ₂ 、NiO	回路基板搭載筐体 飛翔体部品 風洞実験用部品 その他
	導電性	Cu、Ni、Pt	
その他	放射線	W、Ge、Mo	ターゲット ドラム
	温度センサー	AlN/Al	シリコンウェハー
	不溶性電極	Pt、IrO _x	チタン基板
	表面改質	イオンボンバード	樹脂ノズル